



RE965-02PIN

- Adaptador para DPAK3 con pins
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Estañado en caliente (HAL leadfree)
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para DPAK3 con 4,70 mm Pitch
- Con pin header
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Diámetro de los agujeros 1,10 mm con nodos de soldadura Ø 2,10 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 13,50 x 21,50 mm